江苏省半导体行业协会

苏半协字（2026）28号

江苏省半导体行业协会关于废止倒装芯片球栅阵列封装（FCBGA）系列型谱等五项团体标准的公告

依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1 号）及本协会《团体标准管理办法》相关要求，经标准起草单位自评、团体标准管理委员会审议，报江苏省半导体行业协会核准，认为 T/JSSIA 0001—2017 倒装芯片球栅阵列封装（FCBGA）系列型谱等五项团体标准（详见附件）已无实施必要，决定自 2026 年 12 月 1 日起废止。

特此公告

附件：废止团体标准清单

江苏省半导体行业协会

2026 年 11 月 10 日

附件

废止团体标准清单

序号	标准编号	标准名称	发布时间	废止原因
1	T/JSSIA 0001—2017	倒装芯片球栅阵列封装（FCBGA）系列型谱	2017-09-29	无继续实施必要
2	T/JSSIA 0002—2017	倒装芯片球栅阵列封装（FCBGA）外型尺寸	2017-09-29	无继续实施必要
3	T/JSSIA 0003—2017	晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）系列型谱	2017-09-29	无继续实施必要
4	T/JSSIA 0004—2017	晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）外型尺寸	2017-09-29	无继续实施必要
5	T/JSSIA 0005—2017	集成电路封装—塑料四边引线扁平封装（PQFP）	2017-09-29	已有类似国标 GB/T 15879.4-2019、GB/T 15879.603-2026 等